

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Гнезда передатчика RJ45 (магнитные) для гигабитных систем (1000 Base-T) со встроенной компенсацией активно противодействуют индуктивным и емкостным соединениям и экономят место на печатной плате.

Ассортимент продукции включает следующие модели:

- 90°, лежащая (горизонтальная) и 180°, стоящая (вертикальная)
- Защелка верх / защелка вниз;
- Технология пайки ТНТ или THR
- Широкий ассортимент различных видов конструкции, также со встроенными светодиодами и печатными площадками для экранирования
- Скорость передачи данных до 1 Гбит/с
- Упаковка лоток (ТҮ) или рулон (лента на катушке, RL)
- Совместимость с модульным разъемом RJ45 в соответствии со стандартами ANSI/TIA-1096-A и IEC 60603
- Диэлектрическая прочность ≥ 1500 В пер. тока, среднеквадратичное значение (2250 В пер. тока, амплитудное значение) в соответствии со стандартом IEEE 802.3
- Диэлектрическая прочность ≥ 1500 В перем. тока (амплитудное значение) или ≥ 1500 В пост. тока в соответствии со стандартом с IEC 60603

• Соответствие требованиям IEEE 802.3 (1000BASE-T, 1 Гбит/с, IEEE 802.3ab или 100BASE-TX, 100 M6/с, IEEE 802.3u)

Особенности и преимущества:

- Расширенный диапазон температур: от -40 до +85 °C для достижения максимальных значений рабочих характеристик
- Слой золота повышенной прочности (30 мкм) для улучшения защиты от коррозии
- Расстояние по меньшей мере 0,3 мм обеспечивает отличный результат пайки

Основные данные для заказа

Исполнение	Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 100 Мбит/ с , Соединение THT/THR под пайку, 180°,
	С, соединение ттту ттттод палку, тоо , Светодиод: Нет, Количество полюсов: 8, Лоток (ручная сборка)
—————————————————————————————————————	<u>2636810000</u>
Тип	RJ45M R1V 3.3N4N TY
GTIN (EAN)	4050118655834
Кол.	120 Шт.
Упаковка	Лоток (ручная сборка)

Дата создания 18 апреля 2021 г. 4:58:52 CEST



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	17 мм	Высота (в дюймах)	0,669 inch
Глубина	16,8 мм	Глубина (дюймов)	0,661 inch
Масса нетто	999 g	 Ширина	16 мм
Ширина (в дюймах)	0,63 inch	-	

Упаковка

Упаковка	Лоток (ручная сборка)	Длина VPE	0
VPE c	0	Высота VPE	0

Системные характеристики

Вид защиты	IP20	Длина контактного штифта (I)	3,3 мм
Категория эксплуатационных		Количество полюсов	
характеристик	100 Мбит/с		8
Монтаж на печатной плате	Соединение THT/THR под	Светодиод	
	пайку		Нет
Серия изделия	Данные OMNIMATE – штекер преобразователя	Скорость передачи	
	RJ45		100 Мбит/с
Техпроцесс пайки	Пайка оплавлением сквозных отверстий (Reflow), Пайка вручную,	Угол вывода	
	Пайка волной припоя		180°
Шаг в дюймах (Р)	0,05 inch	Шаг в мм (Р)	1,27 мм
Экранирование			

Электрические свойства

Номинальное напряжение	125 V	Номинальный ток	1,5 A
Электрическая прочность, контакт /		Электрическая прочность, контакт /	
контакт	1000 B DC	экран	1500 В пост. тока

Данные о материалах

Изоляционный материал	PA 9T	Цветовой код	черный
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	1
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Рабочая температура, мин.	-40 °C	Рабочая температура, макс.	85 °C

Классификации

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01

Загрузки

Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format	

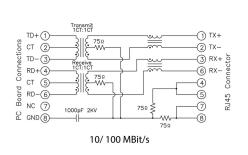


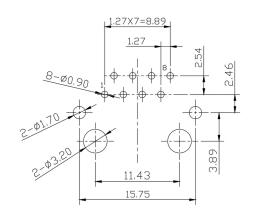
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

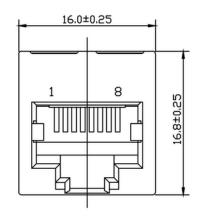
Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

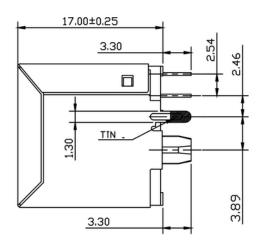
www.weidmueller.com

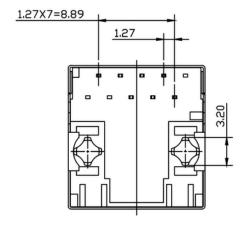
Изображения













Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Схематическое представление

Characteristics

Inductance 350 µH min. @ 100 kHz,

100 mV, 8 mA DC Bias

 Leakage Inductance
 0.3 μH max. @ 100 kHz,100 mV

 Insertion Loss
 1.1 dB max. @ (1 - 100) MHz

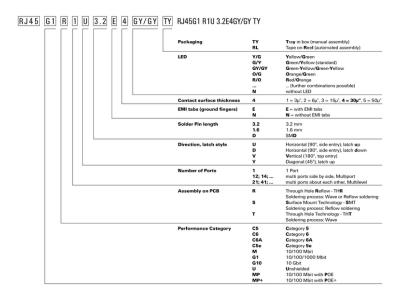
 Return Loss
 18 dB min. @ (1 - 30) MHz

 16 dB min. @ (30 - 60) MHz

12 dB min. @ (60 - 80) MHz

 Cross Talk
 30 dB min. @ (1 - 100) MHz

 Common Mode Rejection
 30 dB min. @ (1 - 100) MHz



Типы кодов



Recommended wave solderding profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

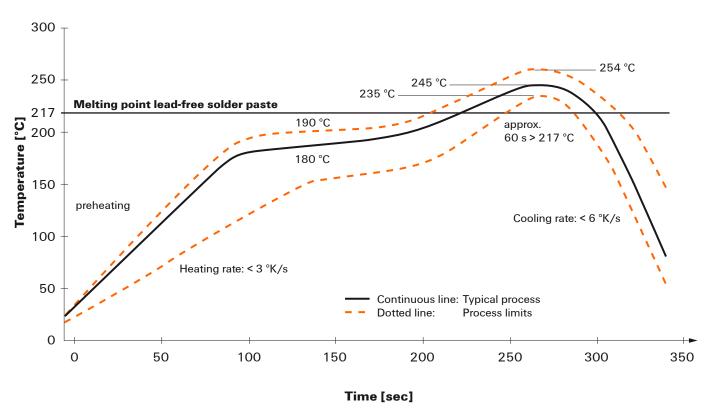


Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- · Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- · Maximum heating rate
- · Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3$ K/s. In parallel the solder paste is ,activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at \geq -6K/s solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.